YS-LD 语音模块使用手册

一、模块与单片机的连接方式

本芯片为 3.3V 供电与其连接的单片机必须为 3.3V 供电的单片机,从而保证 IO 口电平不超过 3.3V,否则将导致语音芯片驱动不成功甚至导致语音芯片烧坏,以下为该模块的 2 种驱动方式的端口连接;(模块管脚定义请查看"YS-语音识别模块说明手册.PDF")

1、并口方式

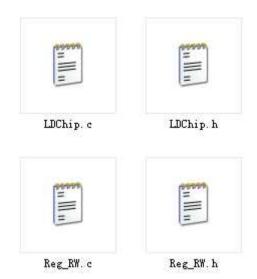
 LD_-CS

```
+
 LD_P0--LDP7 (8位并行数据、地址端口)
          (1: LD_P0-LD_P7为地址端口, 0: LD_P0-LD_P7为s
 LD_A0
           数据端口)
          (芯片片选端口)
 LD_-CS
          (芯片写端口)
 LD_WR
 LD_RD
          (芯片读端口)
           (中断信号,模块收到声音后产生一个下降沿)
 LD_IRO
          (芯片复位端口)
 LD_Reset
2、SPL方式
 LD_P0->SDI
            (SPI 输入端口)
 LD_P1->SD0
            (SPI 输出端口)
            (SPI 时钟端口)
 LD_P2->SDCLK
 LD_WR->SPIS
            (SPI 片选端口)
            (芯片复位端口)
 LD_Reset
           (中断信号,模块收到声音后产生一个下降沿)
 LD_{-}IRO
```

(芯片片选端口, 低电平有效)

二、程序移植调试步骤

1、程序移植:根据自己的单片机使用情况,移植配套程



序,

其中"LDChip.c"程序文

件为 LD3320 芯片的驱动函数; "Reg_RW.c"为读写函数, 该读写函数是通用的,可以读写即可。

- 2、在移植过程中注意不要修改"LDChip.c"中寄存器的配置和初始化函数,用户需要修改"Reg_RW.c"端口定义、读写函数、"LDChip.h"中的时钟宏定义 CLK 实际输入多少则修改为多少、根据晶振情况修改延时函数。
- 3、做好电路连接和移植好程序端口后查看配套的资料 "LD3320 芯片简明调试步骤.pdf"进行程序调试。

(特别说明: LD3320 芯片的调试存在一定的难度,根据单片机基础的水平和 耐心调试时间在 1-15 天不等,只要保证连接电路正确程序耐心根据步骤调试 会很快得到效果。)

三、关于配套的其他资料说明

本模块配套的资料相对比较多,为了不让用户混乱无从下

手,我们建议先查看 该资料包的相关内容进行开发 操作,在开发过程中遇到部分寄存器需要了解或其他不明白

四、其他说明

对于单片机基础不扎实,什么叫做移植程序、什么是主函数、串口等都没弄明白的用户请先打好基础后在进行调试。 或联系本店客服购买一体化自带单片机-免驱动的语音识别 模块。